佛山市唯美乐医疗器材有限公司

超声波洁牙机工作尖系列

VIMEL®
唯美乐

牙周治疗工作尖

牙周治疗专用，临床操作方便

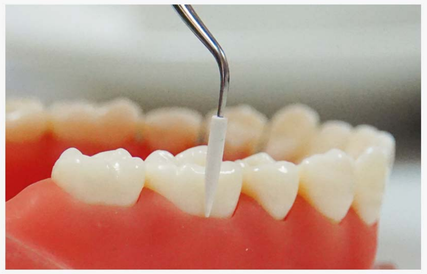
钛合金工作尖

不损伤牙骨质









种植体维护P90

工作尖尖端有PEEK材料包裹

清洁种植体和修复体

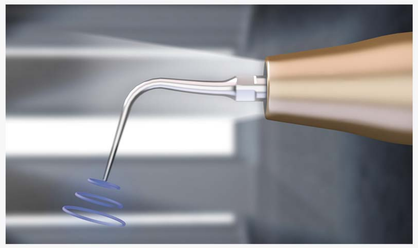
*确保冷却到达工作尖针尖



自动供水 换水方便



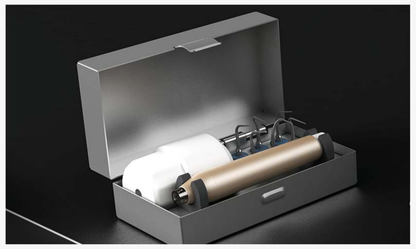
带光手柄　视野清晰



智能触控 一触即控

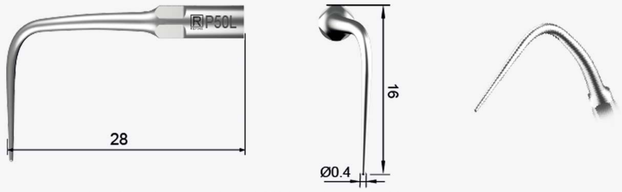


配备两套专业消毒套装



牙周治疗可适配工作尖

P50L

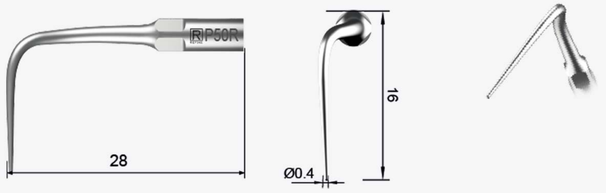


钛合金工作尖，用于龈下牙石探诊，龈下牙邻面刮治，根面平整

针尖与牙长轴垂直，针尖2mm前后方向与牙面贴合，并上下进行移动刮治

★确保冷却水到达工作尖针尖

P50R

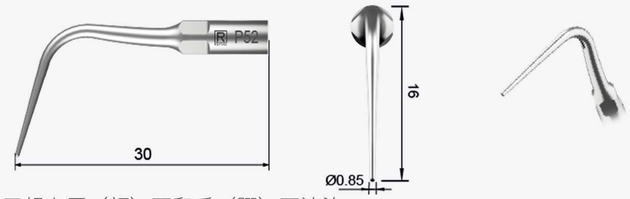


钛合金工作尖，用于龈下牙石探诊，龈下牙邻面刮治，根面平整

针尖与牙长轴垂直，针尖2mm前后方向与牙面贴合，并上下进行移动刮治

★确保冷却水到达工作尖针尖

P52

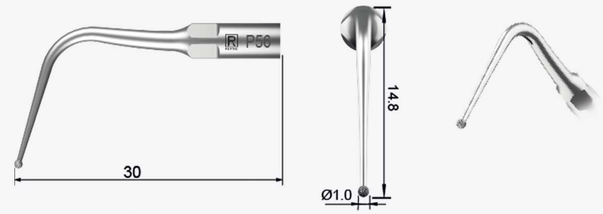


钛合金工作尖，用于龈上唇（颊）面和舌（腭）面洁治

针尖与牙长轴平行，针尖2mm左右方向与牙面贴合，并前后进行移动刮治

★确保冷却水到达工作尖针尖

P56

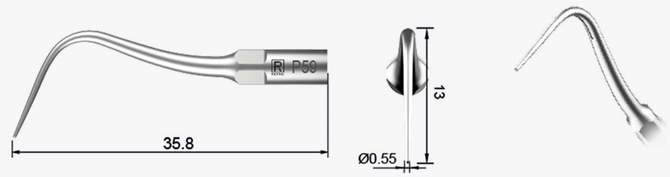


钛合金工作尖，去除龈上唇（颊）面和舌（腭）面大块结石和牙斑

针尖与牙长轴平行，针尖2mm左右方向与牙面贴合，并前后进行移动刮治

★确保冷却水到达工作尖针尖

P59

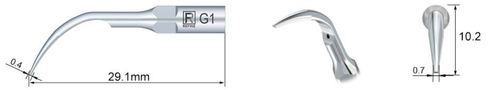


钛合金工作尖，用于龈下牙石探诊，龈下唇（颊）面和舌（腭）面刮治

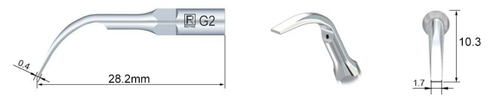
针尖与牙长轴平行，针尖2mm左右方向与牙面贴合，并前后进行移动刮治

★确保冷却水到达工作尖针尖

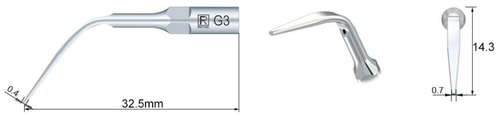
洁治 (适用于Refine, EMS & Woodpecker)

G1


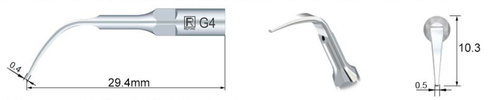
龈上洁治

G2


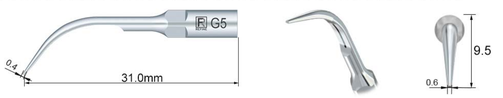
龈上洁治

G3


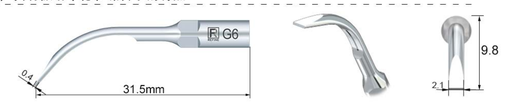
龈上洁治

G4


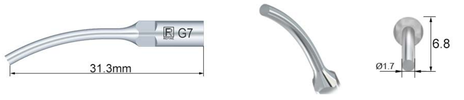
适用型龈上工作尖，用于去除所有牙齿的龈上结石和牙斑

G5


龈上洁治，具有振动平稳和噪音小的特点

G6


用于去除龈上大块结石和牙斑，小功率课直接使用工作尖平头，具有振动平稳和噪音小特点

G7


去冠

G8

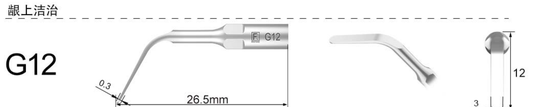

去桩(带水冷却)

G9


龈上洁治

G10


龈上洁治

G12


龈上洁治

G20

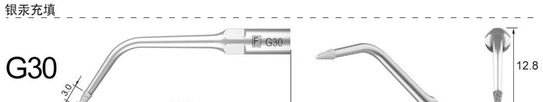

金刚砂镀层，用于牙本质磨除，在车针完成“龈上肩台”制备后用于“龈下肩台”制备

G21

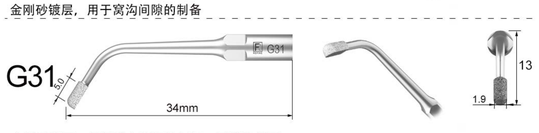

金刚砂镀层，用于牙本质磨除，主要用于已制备的龈上、龈下肩台精修抛光

G28

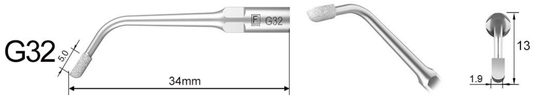

银汞充填

G30


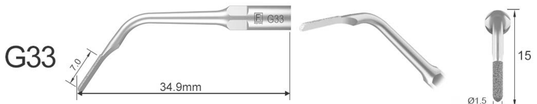
金刚砂镀层，用于窝沟间隙的制备

G31


金刚砂镀层，用于近中窝洞的制备，不损伤邻牙

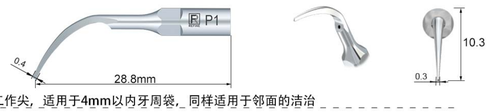
G32


金刚砂镀层，用于远中窝洞的制备，不损伤邻牙

G33


金刚砂镀层，用于牙齿贴面的制备

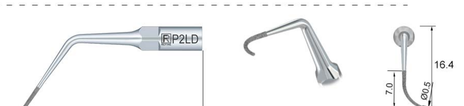
牙周治疗 (适用于Refine, EMS & Woodpecker)

P1


通用型龈下工作尖，适用于4mm以内牙周袋，同样适用于邻面的洁治

P2L


牙周洁治

P2LD


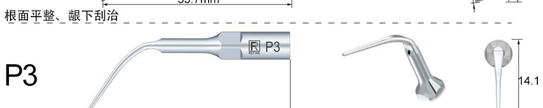
根面平整、龈下刮治

P2R

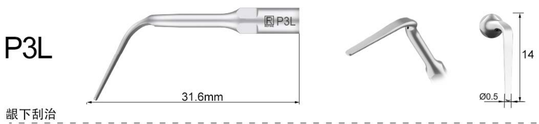

牙周洁治

P2RD

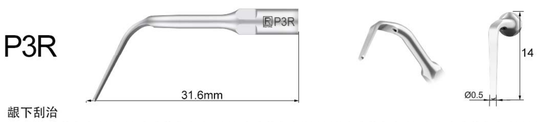

根面平整、龈下刮治

P3


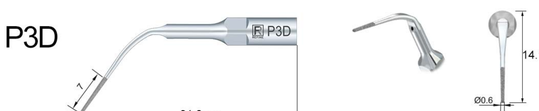
用于龈下牙石探诊，龈下刮治(4mm以上深牙周袋同样适用)

P3L


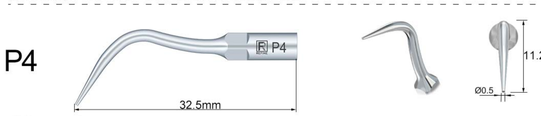
龈下刮治

P3R


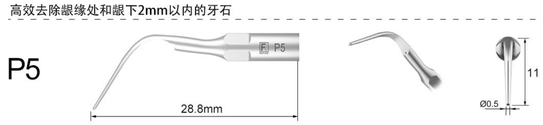
龈下刮治

P3D


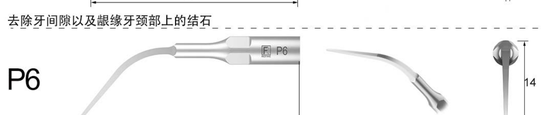
金刚砂镀层，用于翻瓣手术扩大根分叉和抛光牙根面

P4


高效去除龈缘处和龈下2mm以内的牙石

P5


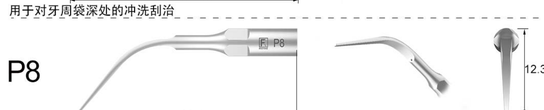
去除牙间隙以及龈缘牙颈部上的结石

P6


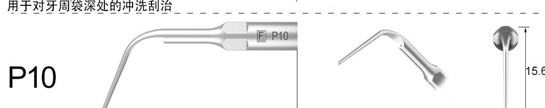
用于对牙周袋深处的冲洗刮治

P7


用于对牙周袋深处的冲洗刮治

P8


用于对牙周袋深处的冲洗刮治

P10


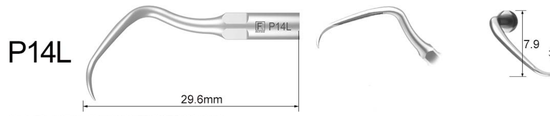
对龈下(牙周袋)进行刮治，去除牙结石

P11


对龈下较难去除的牙结石进行高效去除

P12

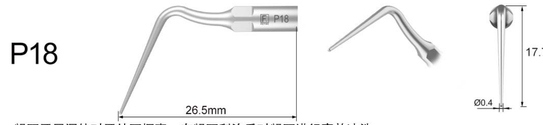

伸入后牙龈对顽固牙结石进行刮治去除

P14L


伸入后牙龈对顽固牙结石进行刮治去除

P14R


伸入后牙龈对顽固牙结石进行刮治去除

P18


龈下牙周深处对牙结石探查，在龈下刮治后对龈下进行高效冲洗

P20


用于牙间隙，牙颈部及龈下3mm内牙结石进行刮治去除

P20L


用于高效去除后牙龈下的顽固牙垢

P20R

用于高效去除后牙龈下的顽固牙垢

P21L

用于后牙牙根分叉区域的洁治及相邻后牙间牙根面的刮治

P21R

用于后牙牙根分叉区域的洁治及相邻后牙间牙根面的刮治

P22L

针尖12mm长直段工作部分保证龈下刮治时完成去除龈下结石和污渍

P22R

针尖12mm长直段工作部分保证龈下刮治时完成去除龈下结石和污渍

P50L

用于龈下牙石探诊，龈下刮治，根面平整(用于较深的牙周袋)

P50R

用于龈下牙石探诊，龈下刮治，根面平整(用于较深的牙周袋)

P52

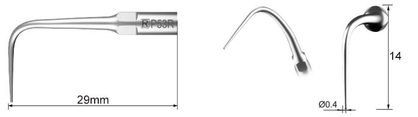
用于龈上洁治，清除牙结石，牙菌斑

P53L

用于龈下牙石探诊，龈下刮治，根面平整(用于较深的牙周袋)

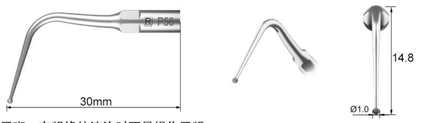
牙周治疗 (适用于Refine, EMS & Woodpecker)

P53R



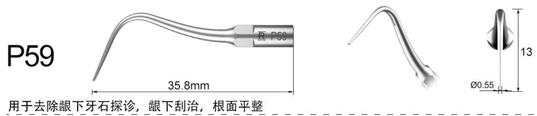
用于龈下牙石探诊，龈下刮治，根面平整(用于较深的牙周袋)

P56



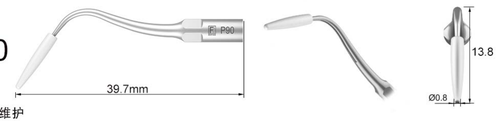
用于去除龈上大块结石和牙斑，在龈缘处洁治时不易损伤牙龈

P59



用于去除龈下牙石探诊，龈下刮治，根面平整

P90



种植体维护

根管治疗 (适用于Refine, EMS & Woodpecker)

E1



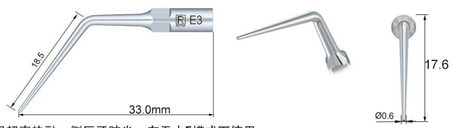
120°根管转接器，根管荡洗

E2



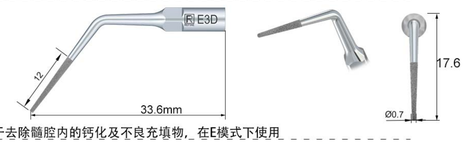
95°根管转接器，根管荡洗

E3



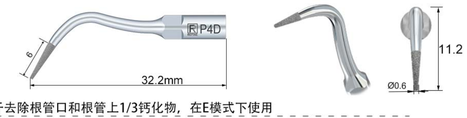
做侧压器使用，利用超声热融、侧压牙胶尖，在无水E模式下使用

E3D



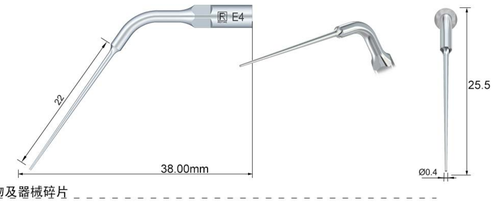
金刚砂镀层，用于去除髓腔内的钙化及不良充填物，在E模式下使用

P4D



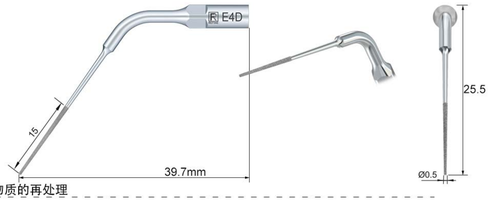
金刚砂镀层，用于去除根管口和根管上1/3钙化物，在E模式下使用

E4



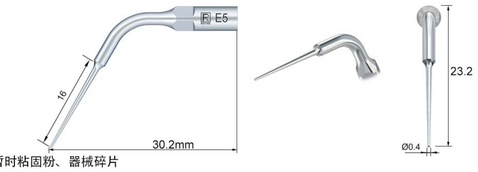
去除根管异物及器械碎片

E4D



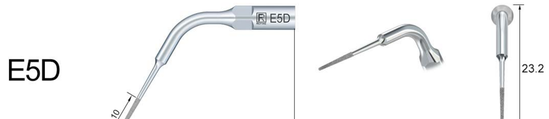
根管内顽固物质的再处理

E5



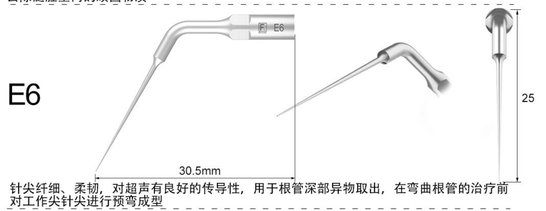
快速去除根管暂时粘固粉、器械碎片

E5D



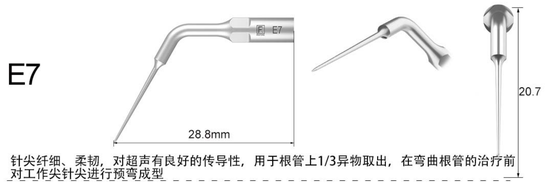
去除髓腔壁内的顽固物质

E6



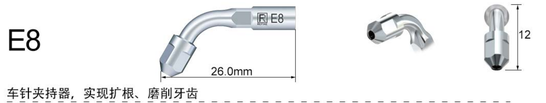
针尖纤细、柔韧，对超声有良好的传导性，用于根管深部异物取出，在弯曲根管的治疗前对工作尖针尖进行预弯成型

E7



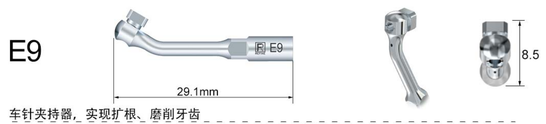
针尖纤细、柔韧，对超声有良好的传导性，用于根管上1/3异物取出，在弯曲根管的治疗前对工作尖针尖进行预弯成型

E8



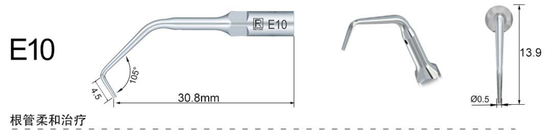
车针夹持器，实现扩根、磨削牙齿

E9



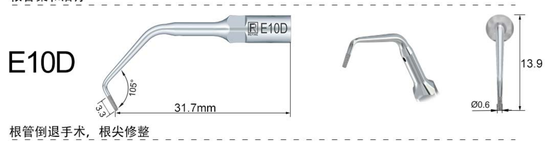
车针夹持器，实现扩根、磨削牙齿

E10



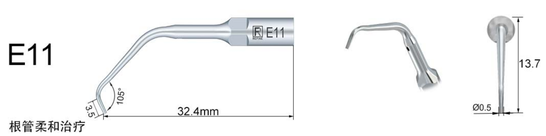
根管柔和治疗

E10D



根管倒退手术，根尖修整

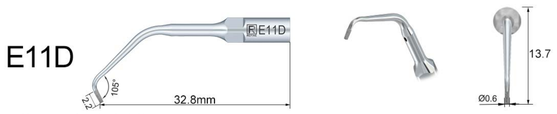
E11



根管柔和治疗

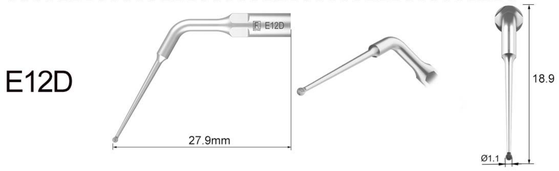
根管治疗 (适用于Refine, EMS & Woodpecker)

E11D



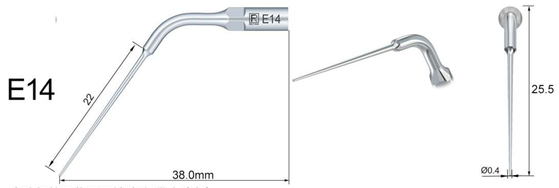
根管倒退手术，根尖修整

E12D



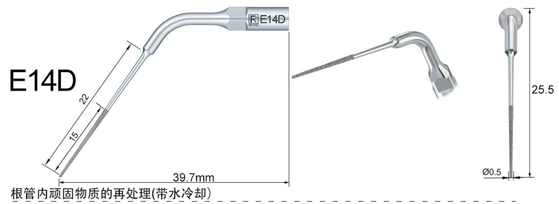
根管髓腔异物，暴露根管口

E14



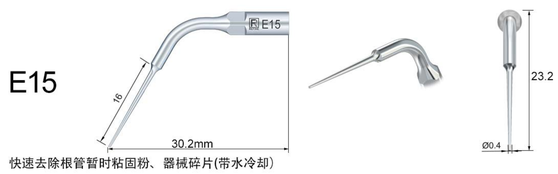
去除根管异物及器械碎片(带水冷却)

E14D



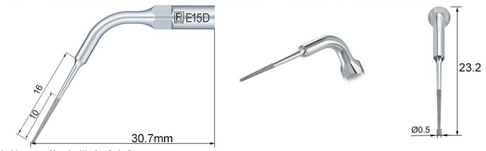
根管内顽固物质的再处理(带水冷却)

E15



快速去除根管暂时粘固粉、器械碎片(带水冷却)

E15D



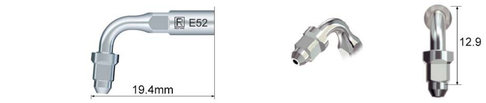
去除髓腔壁内的顽固物质(带水冷却)

E51



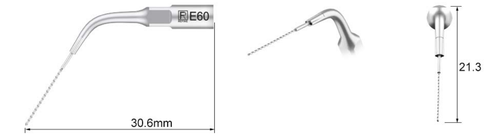
120°根管转接器，用于根管的清理及荡洗，常用于对前牙操作

E52



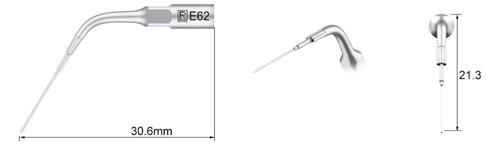
95°根管转接器，用于根管的清理及荡洗，常用于对前牙操作

E60



根管荡洗一体锉，具有轻微切削

E62



开口锉切削大量碎屑后进行超声荡洗

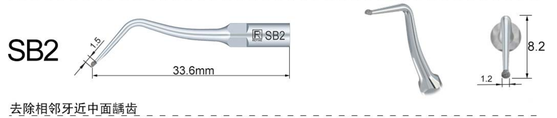
窝洞制备 (适用于Refine, EMS & Woodpecker)

SB1



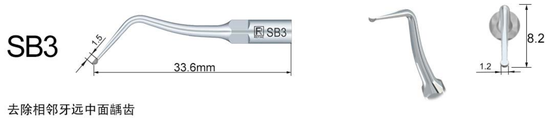
去除牙颈部、牙咬合面龋齿

SB2



去除相邻牙近中面龋齿

SB3



去除相邻牙远中面龋齿

SBL



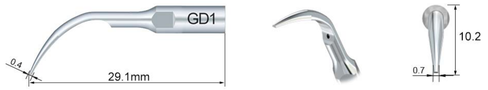
左向45°进入龋齿部位，不伤害邻牙

SBR

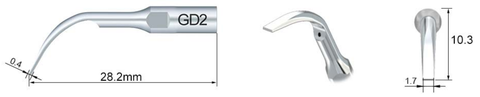


右向45°进入龋齿部位，不伤害邻牙

洁治 (适用于Refine, SATELEC & DTE)

GD1


龈上洁治

GD2


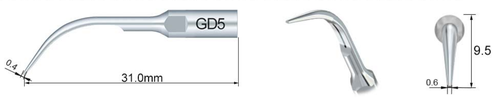
龈上洁治

GD3


龈上洁治

GD4

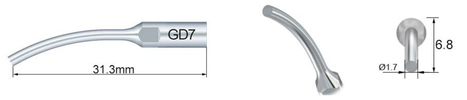

适用型龈上工作尖，用于去除所有牙齿的龈上结石和牙斑

GD5


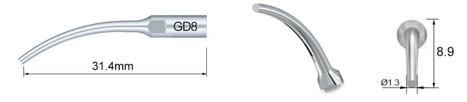
龈上洁治，具有振动平稳和噪音小的特点

GD6


用于去除龈上大块结石和牙斑，小功率课直接使用工作尖平头，具有振动平稳和噪音小特点

GD7


去冠

GD8


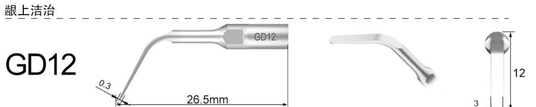
去桩(带水冷却)

GD9


龈上洁治

GD10


龈上洁治

GD12


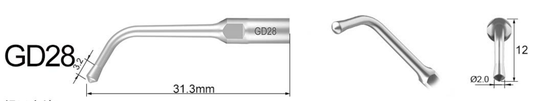
龈上洁治

GD20

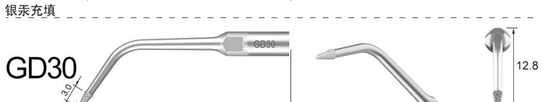

金刚砂镀层，用于牙本质磨除，在车针完成“龈上肩台”制备后用于“龈下肩台”制备

GD21

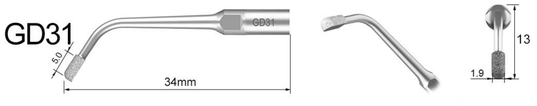

金刚砂镀层，用于牙本质磨除，主要用于已制备的龈上、龈下肩台精修抛光

GD28


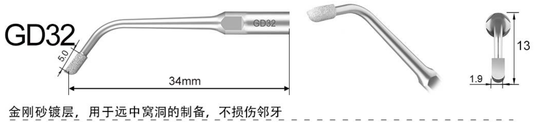
银汞充填

GD30


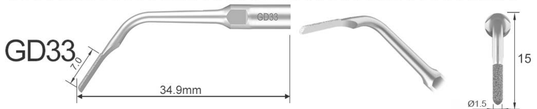
金刚砂镀层，用于窝沟间隙的制备

GD31


金刚砂镀层，用于近中窝洞的制备，不损伤邻牙

GD32


金刚砂镀层，用于远中窝洞的制备，不损伤邻牙

GD33


金刚砂镀层，用于牙齿贴面的制备

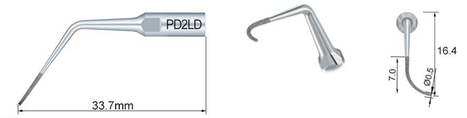
牙周治疗 (适用于Refine,SATELEC& DTE)

PD1


通用型龈下工作尖，适用于4mm以内牙周袋，同样适用于邻面的洁治

PD2L

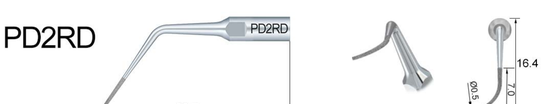

牙周洁治

PD2LD


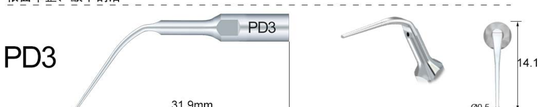
根面平整、龈下刮治

PD2R

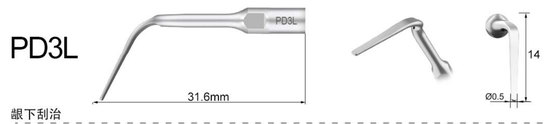

牙周洁治

PD2RD


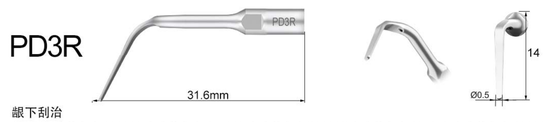
根面平整、龈下刮治

PD3


用于龈下牙石探诊，龈下刮治(4mm以上深牙周袋同样适用)

PD3L


龈下刮治

PD3R


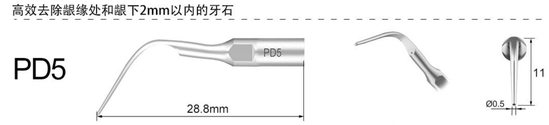
龈下刮治

PD3D

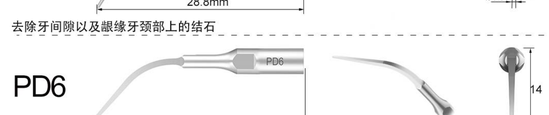

金刚砂镀层，用于翻瓣手术扩大根分叉和抛光牙根面

PD4

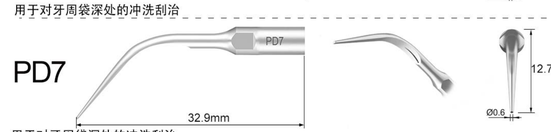

高效去除龈缘处和龈下2mm以内的牙石

PD5


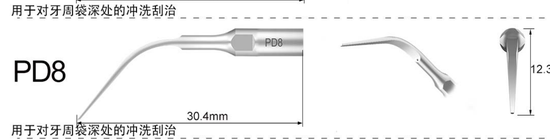
去除牙间隙以及龈缘牙颈部上的结石

PD6


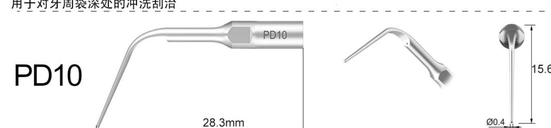
用于对牙周袋深处的冲洗刮治

PD7


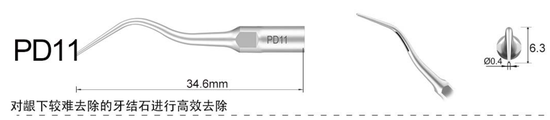
用于对牙周袋深处的冲洗刮治

PD8


用于对牙周袋深处的冲洗刮治

PD10


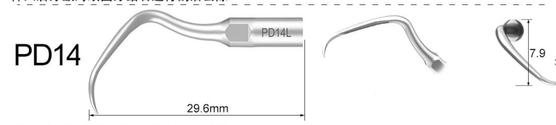
对龈下(牙周袋)进行刮治，去除牙结石

PD11


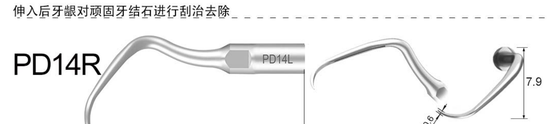
对龈下较难去除的牙结石进行高效去除

PD12

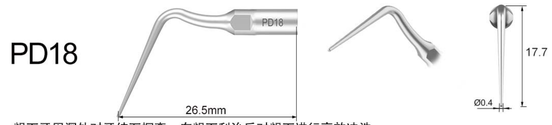

伸入后牙龈对颈固牙结石进行刮治去除

PD14


伸入后牙龈对颈固牙结石进行刮治去除

PD14R


伸入后牙龈对颈固牙结石进行刮治去除

PD18


龈下牙周深处对牙结石探查，在龈下刮治后对龈下进行高效冲洗

PD20


用于牙间隙，牙颈部及龈下3mm内牙结石进行刮治去除

PD20L


用于高效去除后牙龈下的顽固牙垢

PD20R

用于高效去除后牙龈下的顽固牙垢

PD21L

用于后牙牙根分叉区域的洁治及相邻后牙间牙根面的刮治

PD21R

用于后牙牙根分叉区域的洁治及相邻后牙间牙根面的刮治

PD22L

针尖12mm长直段工作部分保证龈下刮治时完成去除龈下结石和污渍

PD22R

针尖12mm长直段工作部分保证龈下刮治时完成去除龈下结石和污渍

PD90

种植体维护

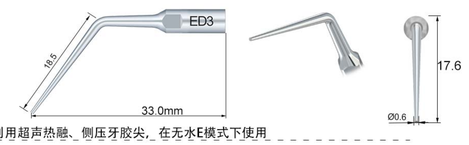
根管治疗 (适用于Refine, SATELEC & DTE)

ED1

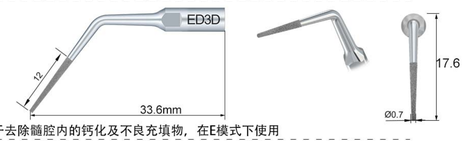

120°根管转接器，根管荡洗

ED2


95°根管转接器，根管荡洗

ED3


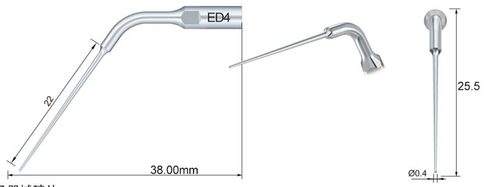
做侧压器使用，利用超声热融、侧压牙胶尖，在无水E模式下使用

ED3D


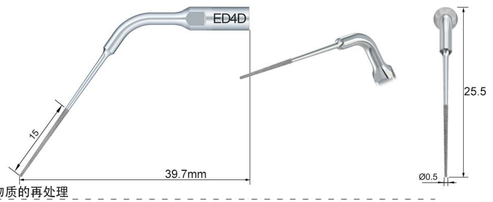
金刚砂镀层，用于去除髓腔内的钙化及不良充填物，在E模式下使用

PD4D

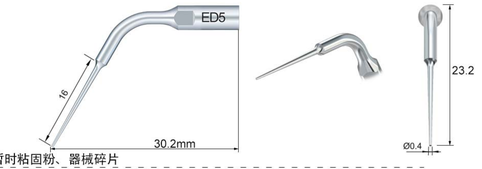

金刚砂镀层，用于去除根管口和根管上1/3钙化物，在E模式下使用

ED4


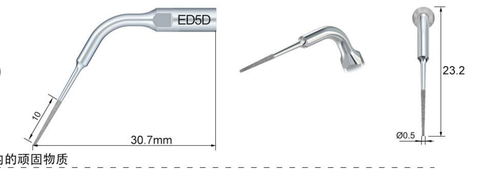
去除根管异物及器械碎片

ED4D


根管内顽固物质的再处理

ED5


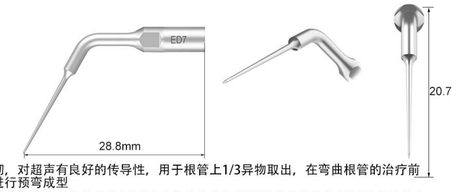
快速去除根管暂时粘固粉、器械碎片

ED5D


去除髓腔壁内的顽固物质

ED6

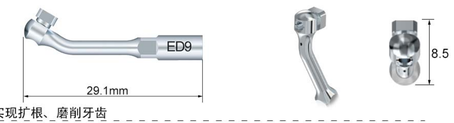

针尖纤细、柔韧，对超声有良好的传导性，用于根管深部异物取出，在弯曲根管的治疗前对工作尖针尖进行预弯成型

ED7


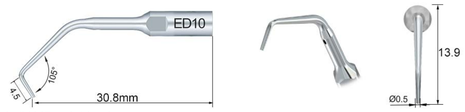
针尖纤细、柔韧，对超声有良好的传导性，用于根管上1/3异物取出，在弯曲根管的治疗前对工作尖针尖进行预弯成型

ED8

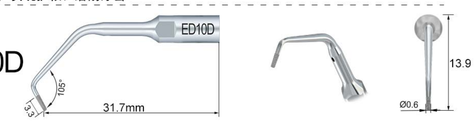

车针夹持器，实现扩根、磨削牙齿

ED9


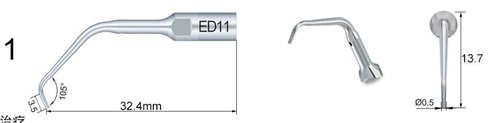
车针夹持器，实现扩根、磨削牙齿

ED10


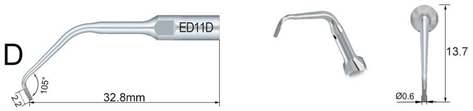
车针夹持器，实现扩根、磨削牙齿

ED10D


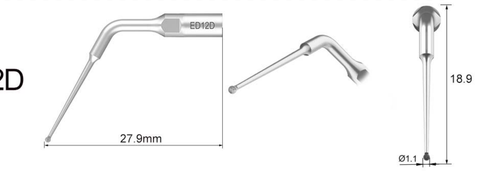
根管倒退手术，根尖修整

ED11


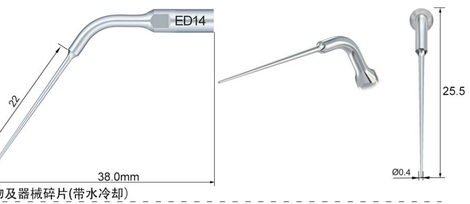
根管柔和治疗

ED11D


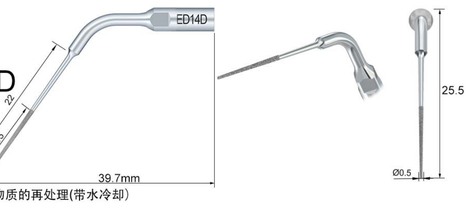
根管倒退手术，根尖修整

ED12D


根管髓腔异物，暴露根管口

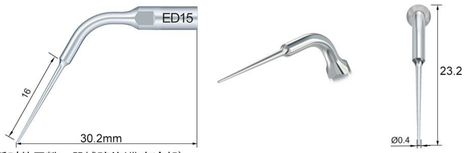
ED14


去除根管异物及器械碎片(带水冷却)

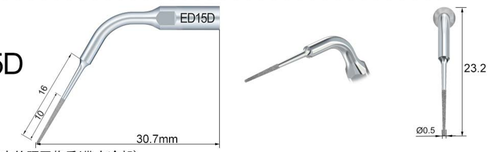
ED14D


根管内顽固物质的再处理(带水冷却)

根管治疗 (适用于Refine, SATELEC & DTE)

ED15


快速去除根管暂时粘固粉、器械碎片(带水冷却)

ED15D


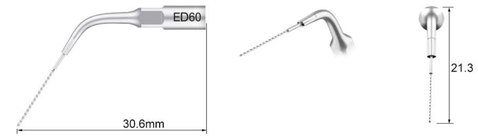
去除髓腔壁内的顽固物质(带水冷却)

ED51

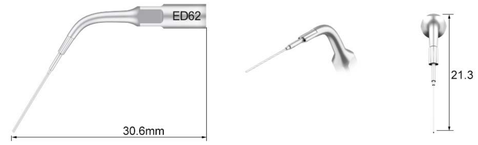

120°根管转接器，用于根管的清理及荡洗，常用于对前牙操作

ED52


95°根管转接器，用于根管的清理及荡洗，常用于对前牙操作

ED60


根管荡洗一体锉，具有轻微切削

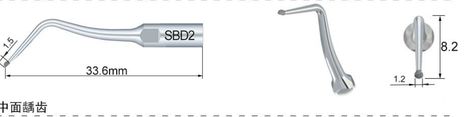
ED62


开口锉切削大量碎屑后进行超声荡洗

窝洞制备 (适用于Refine, SATELEC & DTE)

SBD1


去除牙颈部、牙咬合面龋齿

SBD2


去除相邻牙近中面龋齿

SBD3


去除相邻牙远中面龋齿

SBDL

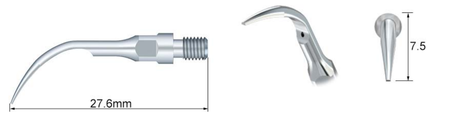

左向45°进入龋齿部位，不伤害邻牙

SBDR


右向45°进入龋齿部位，不伤害邻牙

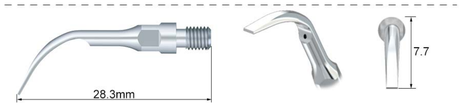
洁治 (适用于SIRONA)

GS1



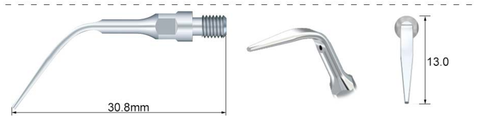
龈上洁治

GS2



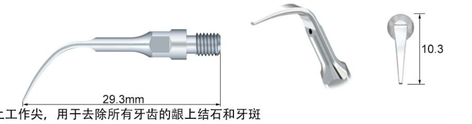
龈上洁治

GS3



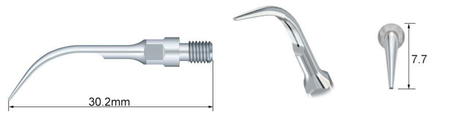
龈上洁治

GS4



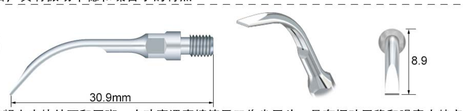
适用型龈上工作尖，用于去除所有牙齿的龈上结石和牙斑

GS5



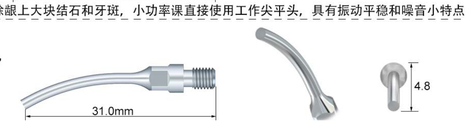
龈上洁治，具有振动平稳和噪音小的特点

GS6



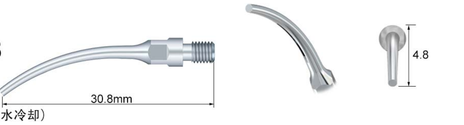
用于去除龈上大块结石和牙斑，小功率课直接使用工作尖平头，具有振动平稳和噪音小特点

GS7



去冠

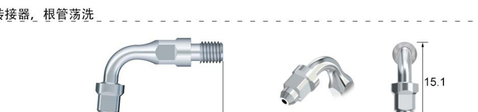
GS8



去桩(带水冷却)

洁治 (适用于SIRONA)

PS1



通用型龈下工作尖，适用于4mm以内牙周袋，同样适用于邻面的洁治

PS3



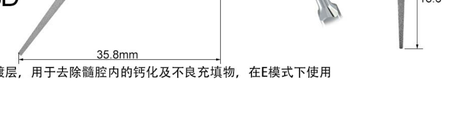
用于龈下牙石探诊，龈下刮治(4mm以上深牙周袋同样适用)

PS4



高效去除龈缘处和龈下2mm以内的牙石

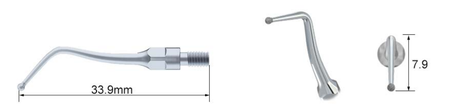
PS3D



金刚砂镀层，用于翻瓣手术扩大根分叉和抛光牙根面

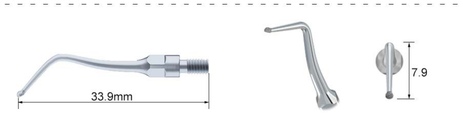
窝洞制备 (适用于SIRONA)

SBS1



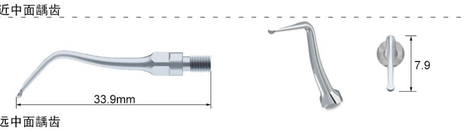
去除牙颈部、牙咬合面龋齿

SBS2



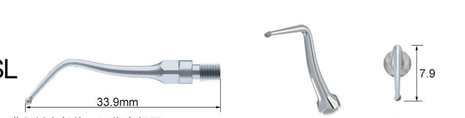
去除相邻牙近中面龋齿

SBS3



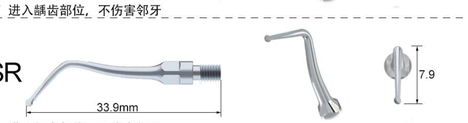
去除相邻牙远中面龋齿

SBSL



左向45° 进入龋齿部位，不伤害邻牙

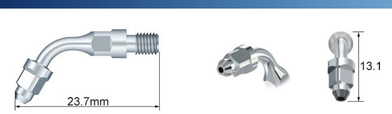
SBSR



右向45° 进入龋齿部位，不伤害邻牙

根管治疗 (适用于SIRONA)

ES1

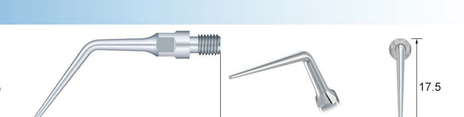


120°根管转接器，根管荡洗

ES2

95°根管转接器，根管荡洗

ES3



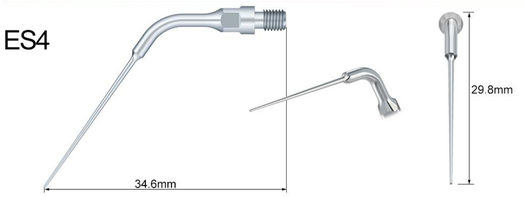
做侧压器使用，利用超声热融、侧压牙胶尖，在无水E模式下使用

ES3D

金刚砂镀层，用于去除髓腔内的钙化及不良充填物，在E模式下使用

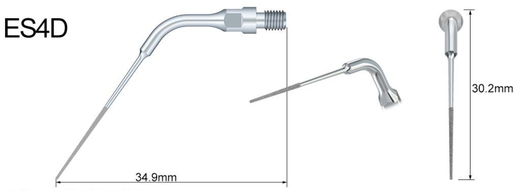
根管治疗 (适用于SIRONA)

ES4



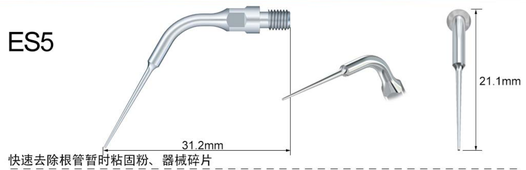
去除根管异物及器械碎片

ES4D



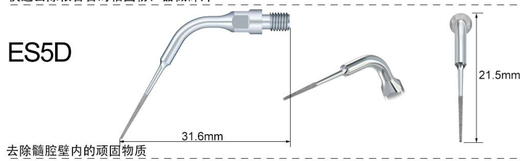
根管内顽固物质的再处理

ES5



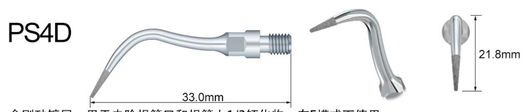
快速去除根管暂时粘固粉、器械碎片

ES5D



去除髓腔壁内的顽固物质

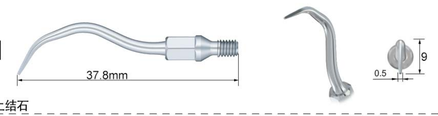
PS4D



金刚砂镀层，用于去除根管口和根管上1/3钙化物，在E模式下使用

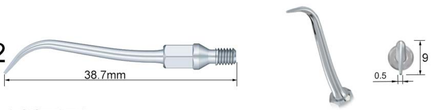
适用于KAVO SonicFlex

GK1



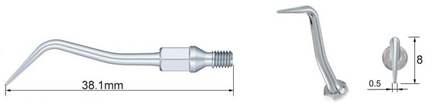
去除龈上结石

GK2



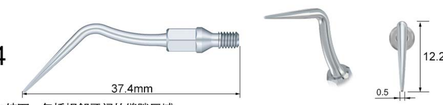
去除龈上大块结石和牙斑

GK3



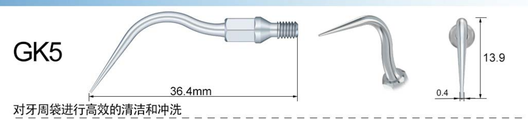
去除龈上、牙间和牙颈部的结石

GK4



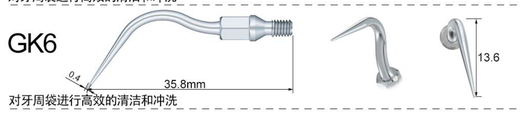
去除龈上结石，包括相邻牙间的缝隙区域

GK5



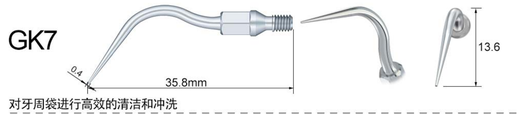
对牙周袋进行高效的清洁和冲洗

GK6



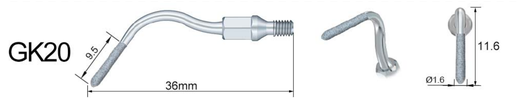
对牙周袋进行高效的清洁和冲洗

GK7



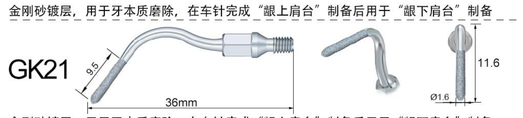
对牙周袋进行高效的清洁和冲洗

GK20



金刚砂镀层，用于牙本质磨除，在车针完成“龈上肩台”制备后用于“龈下肩台”制备

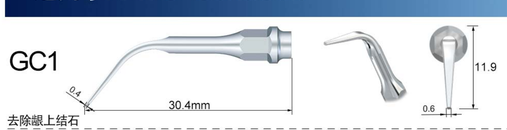
GK21



金刚砂镀层，用于牙本质磨除，在车针完成“龈上肩台”制备后用于“龈下肩台”制备

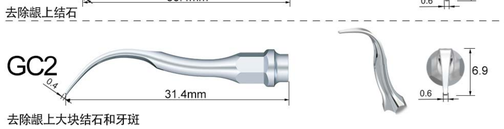
适用于KAVO SonaSoft

GC1



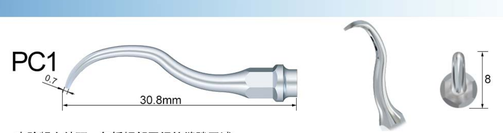
去除龈上结石

GC2



去除龈上大块结石和牙斑

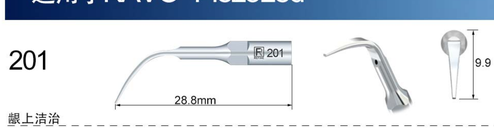
PC1



去除龈上结石，包括相邻牙间的缝隙区域

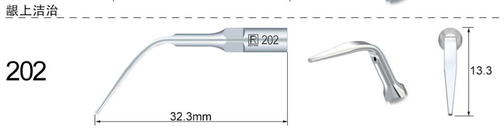
适用于KAVO PiezoLed

201



龈上洁治

202



龈上洁治

203

用于去除所有牙齿的龈上结石和牙斑

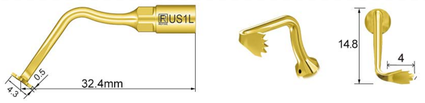
骨切开(适用于 Mectron & Woodpecker)

US1



骨切开术

US1L



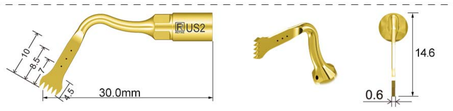
骨切开术

US1R



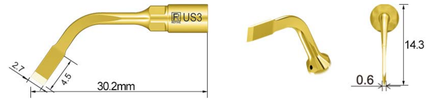
骨切开术

US2



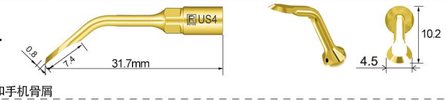
骨切开术

US3



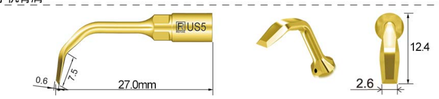
精细骨切开

US4



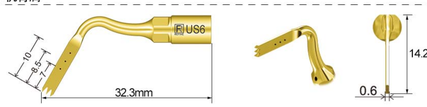
骨成形和手机骨屑

US5



骨成形和手机骨屑

US6



精细骨切开

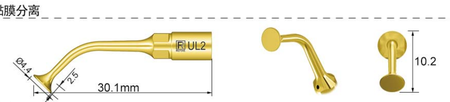
上颌窦提升(适用于 Mectron & Woodpecker)

UL1



120°上颌窦黏膜分离

UL2



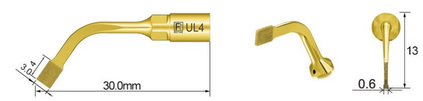
上颌窦黏膜分离

UL3



接近软骨组织及敏感部位的非创伤性骨切开 *金刚砂砂粒大小为100μm

UL4



非常薄的骨切开，避免损伤到软骨组织 *金刚砂砂粒大小为100μm

UL5



95°上颌窦黏膜分离

种植预备(适用于 Mectron & Woodpecker)

UI1



种植手术，针尖尺寸Φ1.6mm

UI2



种植手术，针尖尺寸Φ2mm，中心出水

UI3



种植手术，针尖尺寸Φ2mm，中心出水

UI4



种植手术，针尖尺寸Φ3mm，中心出水

UI5



种植手术，针尖尺寸Φ2mm，中心出水

UI6



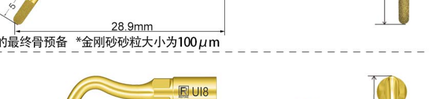
种植手术，针尖尺寸Φ3mm，中心出水

UI7



种植位点的最终骨预备 *金刚砂砂粒大小为100μm

UI8



种植手术，针尖尺寸Φ1.6mm，加长型

UI9



种植手术，针尖尺寸Φ2.8mm，中心出水

根管(适用于 Mectron & Woodpecker)

UE1



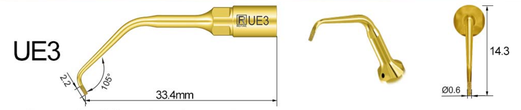
根管倒退手术，高效根尖修整 *金刚砂砂粒大小为40μm

UE2



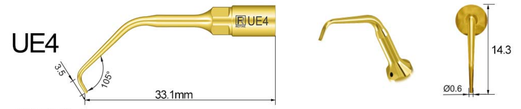
根管柔和治疗

UE3



根管倒退手术，高效根尖修整 *金刚砂砂粒大小为40μm

UE4



根管柔和治疗

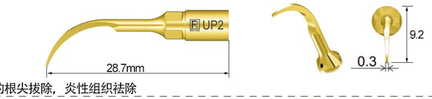
牙周外科(适用于 Mectron & Woodpecker)

UP1



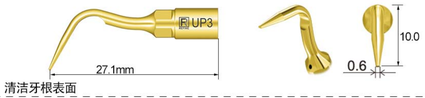
根面刮治，清洁牙根表面

UP2



折断牙根的根尖拔除，炎性组织祛除

UP3



去除牙结石，清洁牙根表面

UP4



根面清创、平整 *金刚砂砂粒大小为40μm

UP5



牙周治疗

UP6



骨成形，术区内部根面平整 *金刚砂砂粒大小为40μm

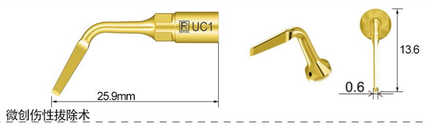
UP7



骨修整，根管扩大 *金刚砂砂粒大小为40μm

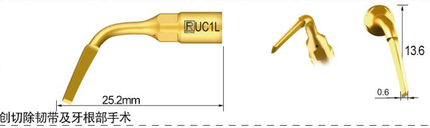
拔除术(适用于 Mectron & Woodpecker)

UC1



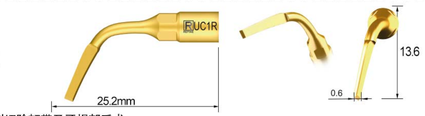
韧带切除术，微创伤性拔除术

UC1L



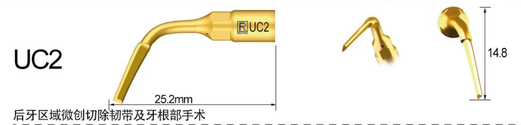
后牙区域微创切除韧带及牙根部手术

UC1R



后牙区域微创切除韧带及牙根部手术

UC2



后牙区域微创切除韧带及牙根部手术

UC3



后牙区域微创切除韧带及牙根部手术